

可编程精密匀胶机

型号：HC150PE

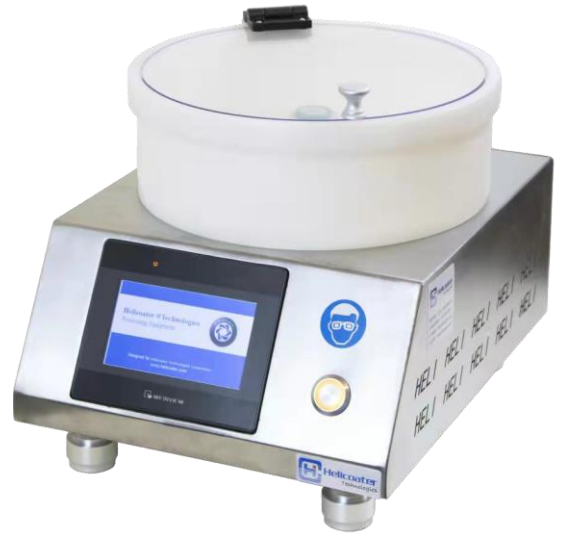
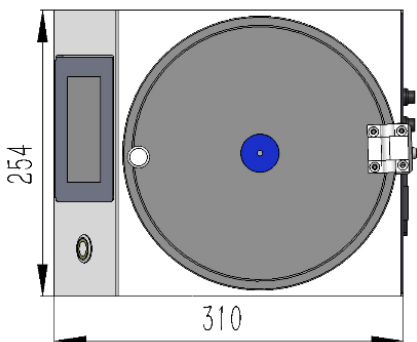


HC150PE匀胶机，采用高级PLC全自动程序控制，转速精度高，稳定性好。可用于微电子、半导体、新能源、生物材料、纳米材料等领域高精度薄膜涂层的制备。

特点：

- 设计紧凑，可放置在手套箱内。
- HDPE高分子材料旋涂内腔，耐腐蚀；采用分体式结构，易清洁和移动；
- 4.3英寸彩色触屏控制，简单易用，运行状态实时显示。
- 不锈钢外壳，美观耐腐蚀。
- 内腔壁采用独特的凹面设计，有效防溅；
- 高级PLC全自动程序控制，可编程100组，每组10步；
- 具有电机进胶保护功能；管路易疏通设计；
- 带真空度安全互锁检测功能；具有真空不足提示及保护功能；具有断电后参数自动保存功能；
- 可设置用户密码保护功能；
- 配置可调基座，方便调节水平；
- 带一路自动点胶接口，可升级自动点胶系统；

设备外形尺寸：长X宽X高：310X254X250mm



技术参数：

- 适用晶元尺寸范围： $\varnothing 5\sim 150\text{mm}$ ；
- 旋涂速度：100~12000rpm；
- 转速分辨率：1rpm；
- 旋涂加速度：100~30000rpm/s；
- 最大旋涂时间：3000s；
- 旋涂时间精度：0.1s；
- 内腔直径212mm，内腔采用独特的凹面防溅设计；
- 具备单步快速旋涂和多步编程旋涂，可编程100组程序，每组程序10步；
- 电源输入：AC200~230V

